

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请授信及相关授权情况概述

为提高公司生产经营运作效率，公司 2020 年度拟向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

公司提请董事会授权董事长赵积清先生或赵积清先生指定的代理人在上述综合授信额度内根据各金融机构及融资租赁机构的具体要求签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），授权期限自本议案经董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。超过上述综合授信额度的部分，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东大会审议。

二、申请授信对公司的影响

向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度符合公司的经营规划及资金需求，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日